

证券代码：300400

证券简称：劲拓股份

公告编号：2024-024

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更，为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日总股本 242,625,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。如在利润分配方案披露之日起至权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟以分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	劲拓股份	股票代码	300400
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	陈文娟		

办公地址	深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）
传真	0755-89481574
电话	0755-89481726
电子信箱	zqztb@jt-ele.com

2、报告期主要业务或产品简介

(1) 主要业务和产品简介

公司主要从事专用设备的研发、生产、销售和服务，主要产品按大类可以划分为电子装联设备（电子热工设备、检测设备、自动化设备）、半导体专用设备和光电显示设备等。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

1) 电子装联设备

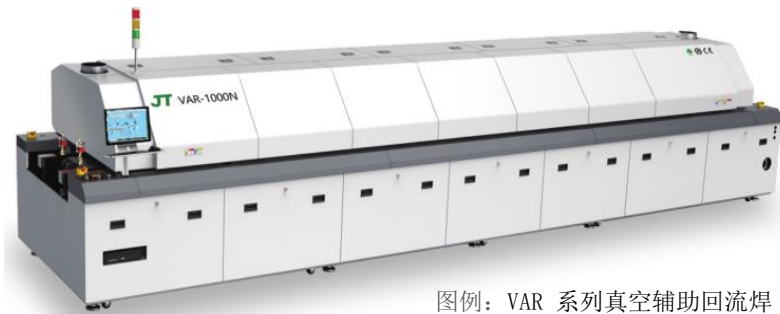
公司电子装联设备覆盖电子产品PCB生产过程中的焊接、检测等多个流程，以“电子热工设备+AOI和SPI检测设备+自动化设备”为下游电子制造领域客户提供一站式服务和整套零缺陷焊接检测制造系统，用以组建电子工业中的PCBA生产线，该类设备能够广泛应用于汽车电子、通信设备、消费电子、航空航天、其他电子产品的生产过程；其中，作为国内电子热工领域龙头企业，公司在电子热工领域具有领先的技术优势、扎实的制造能力和完善的配套服务体系，回流焊等热工设备全球市场份额居前。



图：电子装联设备部分应用领域

① 电子热工设备主要产品及应用领域

电子装联设备中的电子热工设备由公司自主研发、生产和销售，拥有温度控制及传热方面的核心技术，此类产品主要功能是将表面贴装元器件与 PCB 进行组装，应用于电路板组装制程领域。

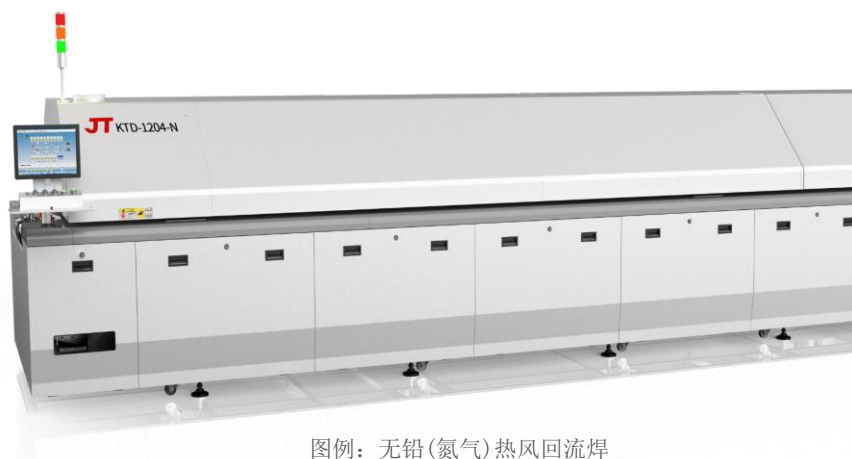


真空回流焊
系列产品可用于车载控制板及 LED、新能源 IGBT 模块、通讯电子、5G 等。

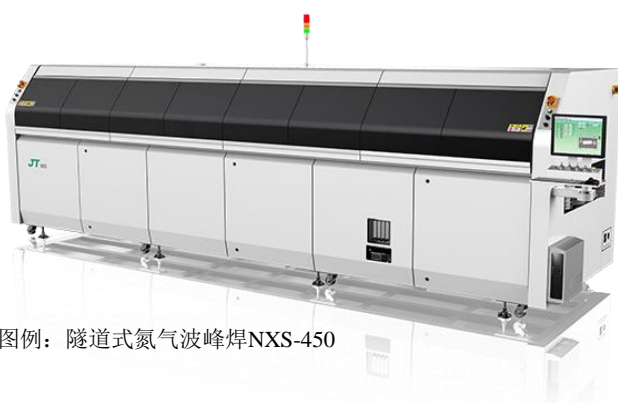
图例：VAR 系列真空辅助回流焊

■ 热风（无铅）回流焊

系列产品可用于Mini LED直显和背光的IMD、COB、COG等封装工艺，以及家电电子PCB、小功率电源板、一般电子控制板、LED等产品制造，能够满足智能手机、通讯、汽车电子、服务器、航空等高品质要求的产品。



图例：无铅(氮气)热风回流焊



图例：隧道式氮气波峰焊NXS-450

■ 无铅(氮气)波峰焊锡装置

系列产品可用于储能产品、服务器类主板、充电桩大功率电源主板、高端汽车电子产品，以及白色家电电子PCB、小功率电源板、一般电子控制板等制造过程。

■ 立式固化炉

用于手机主板、电脑主板、电视主板、通讯主板、新能源等相关电子产品的生产。



图例：JTL系列立式固化炉

②周边设备主要产品及应用领域

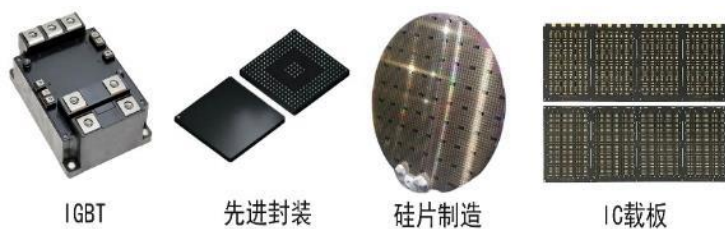
公司电子装联设备之周边设备包含检测设备、自动化设备；其中，检测设备拥有运动控制和视觉识别方面的核心技术，主要功能是在电子产品生产中对PCB上焊点和元器件进行检测，应用于电路板组装制程领域，与电子热工设备组成零缺陷SMT生产线。



电子装联之周边设备还包含自动化设备，自动化设备主要为与公司电子热工设备和检测设备配套使用的相关设备，包括助焊剂喷雾机、接驳台及其他周边设备。

2) 半导体专用设备

半导体专用设备业务系公司战略级业务，公司充分发挥电子热工领域的同源技术领先优势，顺利地将产品线延伸至半导体热工设备领域，并攻关封测环节一些存在国产替代空间的设备，应用领域已涵盖 IGBT 模块、封装、IC 载板、Wafer Bumping、Clip Bonding、FCBGA 等生产制造领域。



图：半导体专用设备部分应用领域

公司半导体专用设备主要为用于芯片先进封装制造等生产环节的热处理设备，具体包含半导体芯片封装炉、Wafer Bumping 焊接设备、甩胶机、氮气烤箱等，主要客户及潜在客户为国内外半导体封测

厂商。

■ 半导体芯片封装炉

应用于各类芯片元器件的封装过程



■ Wafer Bumping 焊接设备

主要应用于晶圆级封装 (WLP)



■ 无尘氮气烤箱、无尘压力烤箱

主要应用于胶水静置和固化，整体提高产品可靠性。



■ 半导体Clip Bonding真空炉

主要应用于Clip Bonding工艺的功率器件。

■ 半导体甲酸真空炉

适应新能源IGBT封装、大功率器件、圆晶级先进焊接工艺，满足真空环境下不同合金材料的高温焊接要求。



3) 光电显示设备

公司光电显示设备用于光电平板（TP/LCD/OLED）显示模组的生产制造过程，按功能分类主要有 2D/2.5D/3D 贴合设备、生物识别模组生产设备、LCM 焊接类设备、贴附机等，相关产品已经覆盖 AMOLED 柔性屏、曲面屏、折叠屏、车载屏、可穿戴类屏体、光电模组、半导体复合铜片贴合等多种应用领域。



图：光电显示设备部分应用领域

公司光电显示业务主要客户为大型面板制造商和模组生产商，已与头部面板厂商京东方等长期深度合作，核心产品因突破国外技术封锁应运而生，应用领域逐步延伸至 AMOLED 柔性屏、曲面屏、折叠屏、车载显示、硅基 OLED 显示、可穿戴类显示等；近年来在市场逆境下保持较强韧性，核心客户粘性较好、产品和技术不断升级、持续贡献销售收入。



3D 曲面贴合设备

应用于贴合装饰膜、防爆膜、Sensor膜、光学膜等。

D-Lami 贴合设备

应用于柔性OLED屏与曲面玻璃盖板的贴合。

屏下指纹模组全自动邦定&贴附设备

用于指纹识别Sensor与FPC（柔性线路板）之间的邦定连接，以及超声波指纹模组IC+Sensor贴合、光学指纹模组的贴合、贴附、封边点胶及固化等。

（2）公司行业地位

1) 公司在电子装联设备之电子热工领域处于领先地位，被行业协会授予“SMT 领域龙头企业”，回

流焊设备获国家工信部“制造业单项冠军产品”认证。公司自主研发的检测设备和自动化设备实现对电子热工设备的辅助和功能扩展，丰富了公司产品的应用场景，与电子热工设备配合为客户提供覆盖电子产品 PCB 生产过程中插件、焊接和检测的整套系统解决方案。

2) 公司半导体专用设备实现关键技术突破，研制生产了多款具有一定技术壁垒的国产空白的半导体热工设备，为国内外大型封测厂商提供产品和服务，并具备为客户提供不同制造工艺设备的定制能力。公司半导体专用设备产品迄今已累计交付及服务客户约 48 家，包括下游典型核心封测厂商客户，并获得客户的认可、验收及复购，成为公司战略级业务和未来成长点。

3) 公司光电显示设备为京东方等国产面板厂商供货并实现长年深度合作，系国内光电显示专用设备主要厂商之一。公司光电显示设备产品在多个品类实现进口替代，应用领域覆盖 AMOLED 柔性屏、曲面屏、折叠屏、车载屏、可穿戴类屏体、光电模组、半导体复合铜片贴合等，积累了丰富的产品技术和场景应用经验，能够满足不同行业客户、不同应用场景、不同载体基础上的多样化需求。

(3) 主营业务分析

2023 年度，公司实现营业总收入 72,014.67 万元，较上年同期减少 8.98%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,942.14 万元，较上年同期减少 55.76%。

1) 营业收入分析

在传统消费电子市场降温、电子行业相关固定资产投资放缓的背景下，公司电子装联业务报告期内实现营业收入 55,406.08 万元，较上年同期减少 16.40%。公司光电显示业务报告期内收入得以释放，确认营业收入 10,053.35 万元，同比增长 199.61%。公司半导体专用设备业务报告期内受到市场环境和验收确认收入进度影响，累计实现营业收入 2,369.35 万元，同比减少 14.79%，意向客户储备继续增加。

伴随着 5G 通讯、物联网、新能源等技术广泛应用，催生新型硬件市场需求增长，有望带来结构性市场机会；各类电子元件、半导体器件小型化、集成化、轻薄化、精细化趋势，对制造工艺水平要求不断提高，进而对相关专用设备性能水平、智能化水平等提出更高的要求。公司作为电子装联设备领域领先厂商、芯片封装热处理国产空白设备的供应商，有望发挥领先优势，进一步提升相关业务市场占有率。

2) 归属于上市公司股东的净利润分析

毛利率方面，公司综合毛利率同比下降 2.42 个百分点，主要是毛利率相对低于其他品类的光电显示业务收入较快增长、收入占比高于上年同期；其中，光电显示业务产品定制化程度相对高、产品结构的不同也导致毛利率水平的差异，公司将落实差异化竞争和精益管理措施，提升光电显示业务毛利率水平。

净利润方面，公司第一期、第二期员工持股计划及限制性股票计提的股份支付费用，对报告期净利润影响金额为 1,128.48 万元。此外，公司持续强化研发创新，研发投入同比增加 690.63 万元，对净利润造成一定影响。公司贯彻长短期人才激励措施，尤其注重研发人才的选育留用，有利于夯实核心竞争力、保障公司持续高质量发展。

3) 主要经营情况回顾

报告期内，公司经营层在董事会领导下，积极推动2023年度经营计划落地，具体经营情况如下：

①推动半导体专用设备业务高质量发展，提速扩大生产和销售规模。

公司根据市场情况及自身经营实际，确立了半导体业务聚焦于后道封测领域的业务发展战略，适时整合了半导体业务经营主体、提高运营效率。2023年度，公司继续推动半导体专用设备业务产品和技术创新，封测设备领域在现有的半导体甲酸真空炉、半导体Clip Bonding真空炉及无尘压力烤箱等多款产品基础上，开发新产品、进一步丰富产品储备。

报告期内，公司继续围绕半导体封测领域接洽有关意向客户和潜在客户，进一步拓展客户群体；参加行业展会活动，开展品牌宣传和传播，拓展潜在客户群体；截至报告期末，半导体专用设备累计交付和服务客户约48家。主要受到外部市场环境、客户固定资产投资计划以及已交付产品验收确认收入进度的影响，半导体专用设备业务报告期内实现营业收入2,369.35万元。

②提高电子装联业务技术壁垒，拓展产品应用领域和增长空间。

2023年度，公司继续结合客户端不同应用场景反馈信息和产品迭代要求，推动电子热工设备性能改善、智能化升级；周边设备与电子热工设备共享客户资源、充分发挥协同效应，在全方位满足客户需求的同时，扩大相关收入来源和销售规模。

报告期内，公司在与现有核心大客户继续密切合作的基础上，重点开发高端客户，同时通过积极参加各类展会、行业活动等，加强新产品营销推广和产业链上下游交流。在电子行业固定资产投资放缓的背景下，报告期内，公司实现电子热工设备销售收入50,158.93万元，周边设备销售收入5,247.15万元。



2023慕尼黑上海电子生产设备展



2023北京智能制造及SMT技术交流会



NEPCON ASIA 2023亚洲电子展



2023深圳国际智能装备产业博览会

公司还将持续通过特定产品创新升级，提高产品附加值和毛利率，同时增加产品在汽车电子、通信设备、消费电子、航空航天、其他电子产品生产领域的应用，继续挖掘应用深度、打开增长空间，提升产品中高端市场占有率。

③挖掘光电显示业务增长潜力，把握行业复苏机遇。

报告期内，公司光电显示业务实现营业收入10,053.35万元、同比增长199.61%。公司将继续把握优质客户合作机会，立足于车载等领域差异化竞争策略，挖掘光电显示业务增长潜力，力争把握市场复苏机遇，推动市场份额提升。

④产业与资本相结合，挖掘主营业务发展新机会。

2023年度，公司落实资本为经营赋能的经营计划，立足于促进主营业务发展的原则，通过与专业投资机构、产业内优质企业联动，积极寻找优质投资标的、链接上下游企业，为“以投资带动研发创新、产品销售”的模式进行了有益尝试。

⑤落实核心骨干和员工的长效激励，赋能适应公司发展新需求的管理团队。

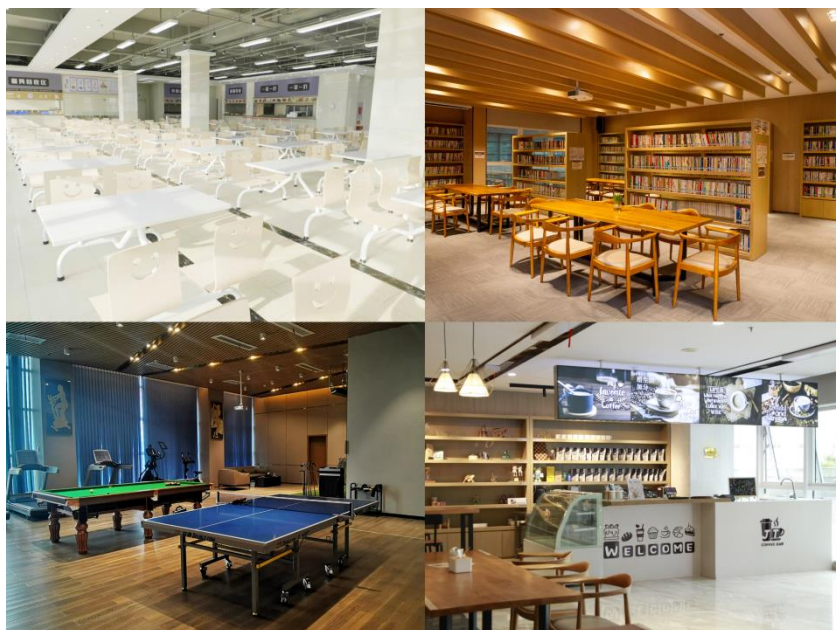
为更好地吸引、培育、留住优秀人才，公司注重长期激励机制建设，实施股份回购用于股权激励、员工持股计划标的股份。报告期内，公司在2022年员工持股计划、2022年（第二类）限制性股票激励计划基础上，进行长效激励计划的持续管理；针对主营半导体专用设备业务的重要子公司，筹划管理层激励措施，优化人员结构、实现长效利益绑定；优化管理层薪酬结构，强化落实绩效考核机制，充分挖掘核心员工团队的能动性；开展内部专业培训、高学历、高技能人才选育，提高员工职业能力和综合素质，不断培育人才、赋能团队。

⑥优化组织结构和管理流程，提高管理运营效率。

随着产品范围和应用领域拓宽、细分业务增加，公司不断优化组织结构和管理流程；继续深化落实事业部运营模式，针对发展半导体专用设备业务的子公司思立康和至元给予独立发展空间；公司动态调整了营销、研发等团队组织架构，将不同业务、地区的业务发展目标压实到人，形成按地域、产品分类的营销和研发管理模式，挖掘和发挥核心团队能动性；进一步整合人员、清理业务条线，集中资源投入到更有前景的项目中去；推动部分管理和审批流程电子化，提高流程效率；改善工作环境、强化后勤部门服务意识、打造团结互助的组织氛围，降低沟通协作成本，提高管理运营效率。

⑦丰富员工福利保障和文化生活，增强员工归属感和凝聚力。

公司注重人性化管理，为丰富员工业余文化生活、保障员工生活品质，不断改善食住行条件，为员工提供暖心服务；组织员工餐委会，监督食堂运行，引入食堂竞争机制、听取员工意见择优选择餐饮供应商、优化餐饮结构；报告期内在原有健身房、员工活动中心、篮球场的基础上，增加了部分生活服务项目，为员工供应咖啡、鲜奶等高质量饮品和水果，接连举办多项业余文化活动，为员工提供休闲娱乐机会，增进员工交流、提高员工幸福感、归属感和凝聚力。



图：公司食堂、图书馆、员工活动中心、咖啡吧

(4) 2024 年经营计划

1) 强化技术研发和产品创新，持续增强新质生产力。

公司坚持自主研发创新，以领先的产品和技术铸就护城河，在电子装联、光电显示、半导体业务方面均取得积极成果。2024 年度，公司将进一步加强研发创新、加大研发投入力度，鼓励对设备产品的结构和性能改进、智能化升级，实现和保持产品性能全面领先；通过打造“技术研发+应用工程”相结合的多层次研发团队，完善“项目驱动、能上能下”的激励和管理机制，运用扁平化、矩阵式、灵活化管理模式，充分激发研发团队创造力、能动性，将“高科技、高效能、高质量”的新质生产力理念内化为组织精神，以强有力的创新、创造工作持续增强新质生产力。

2) 推动半导体业务高质量发展，扩大客户储备和销售规模。

公司经过近些年的探索和实践，将产品线延展至半导体专用设备领域，并确定了聚焦于半导体热工设备的业务发展战略。2024 年度，公司将围绕既定业务战略，在现有已成熟的产品线基础上，积极链接产业链上下游资源，锚定核心客户深化合作，扩大新增客户群体，扩大产品销售规模；同时继续推动新产品研发试制，促进半导体专用设备业务研发成果转化，增强产品核心竞争力，以及不同类型产品生产能力和产品定制能力；汇聚在先进技术、客户群体、产品经验、资金方面的资源，形成内外合力助力半导体业务加速发展，提升公司在半导体设备领域的品牌影响力和核心竞争力。

3) 继续升级电子装联设备，持续增强市场竞争力。

公司电子装联业务属于优势业务和基本盘，尤其是电子热工业务处于行业领先地位。2024 年度，公司将继续落实研发创新工作要求，以数字化、智能化升级为路径之一，大力推进产品和技术迭代；在巩固现有产品市场、稳定销售业绩的基础上，提高电子热工业务核心技术壁垒，提升中高端领域的市场

份额；将产品应用领域向 Mini LED、新能源 IGBT 模块、储能产品、充电桩大功率电源主板、车载控制板及 LED、高端汽车电子产品等多个市场延展和深入，打开新的增长空间，力争扩大该品类营业收入、增厚经营业绩。

4) 光电显示业务差异化竞争，把握市场复苏机遇。

随着下游消费电子需求复苏，叠加汽车电子等中大尺寸显示模组需求增加，光电显示模组行业迎来新的机遇。2024 年度，公司将加强与战略客户的深度合作，促进光电显示设备的销售规模提升，保持业务的连续性；在把握手机显示领域业务机会的同时，推动光电产品应用领域继续向车载显示、硅基 OLED 显示、可穿戴类显示等领域延伸，落实差异化竞争策略、更好地挖掘销售增长潜力，把握市场复苏带来的机遇。

5) 进一步强化内部控制建设，持续提高公司治理水平。

公司多年以来积极践行企业公民义务，遵守国家法律法规、规范性文件的规定，保障社会相关方利益。2024 年度，公司将结合资本市场制度改革以及对上市公司内部控制的各项要求，持续向细、向深、向实地自查和完善内部控制制度体系、贯彻执行规范的工作流程；治理层自上而下地加强法规、制度学习，将公司治理的合规要求落实经营管理的方方面面；结合信息化、数字化手段，在提高运营和管理效率的同时，切实提高公司治理、规范运作水平，更好地保障全体股东及公司利益相关方的合法权益。

6) 落实长效激励和福利措施，打造适应高质量发展需要的组织。

公司坚持“以人为本”的管理理念，落实长短期相结合的激励措施，多年来在研发、技术等核心人才选育留用方面取得有效成果。2024 年度，公司将继续落实长期激励约束机制，通过母公司、子公司多层股权激励凝聚核心人才团队，通过强化定期绩效考核机制压实岗位责任；持续健全员工福利保障机制，服务于员工衣食住行、让劳动者无后顾之忧，打造高效能员工和人才组织。

公司上述经营计划并不构成公司对投资者的实质承诺，提请投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	1,186,321,062.45	1,238,909,784.86	-4.24%	1,231,839,311.01
归属于上市公司股东的净资产	797,595,589.52	740,978,028.92	7.64%	747,809,852.71
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023 年年度报告摘要

营业收入	720,146,735.34	791,177,847.70	-8.98%	989,178,447.86
归属于上市公司股东的净利润	39,421,370.20	89,103,329.41	-55.76%	79,975,673.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,920,191.24	76,567,969.57	-58.31%	61,515,680.10
经营活动产生的现金流量净额	100,349,075.61	129,064,893.85	-22.25%	17,626,349.28
基本每股收益（元/股）	0.1625	0.3672	-55.75%	0.3296
稀释每股收益（元/股）	0.1625	0.3634	-55.28%	0.3296
加权平均净资产收益率	5.15%	12.13%	-6.98%	11.30%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	142,272,559.00	257,255,466.34	157,262,346.90	163,356,363.10
归属于上市公司股东的净利润	2,649,940.21	30,155,923.39	5,763,281.71	852,224.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	838,715.19	26,872,697.81	5,502,572.14	-1,293,793.90
经营活动产生的现金流量净额	4,318,474.15	13,548,552.52	45,421,330.93	37,060,718.01

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,087	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,907	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
吴限	境内自然人	32.86%	79,729,018.00	0.00	质押	46,686,382.00			
麦旺球	境内自然人	2.17%	5,267,149.00	0.00	不适用	0.00			
麦容章	境内自然人	1.57%	3,816,571.00	0.00	不适用	0.00			
孙见清	境内自然人	1.52%	3,700,000.00	0.00	不适用	0.00			
主遼	境内自然人	1.26%	3,047,235.00	0.00	不适用	0.00			
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	1.22%	2,960,820.00	0.00	不适用	0.00			
王希坪	境内自然人	1.16%	2,804,179.00	0.00	不适用	0.00			
许惠敏	境内自然人	1.07%	2,585,700.00	0.00	不适用	0.00			
玲珑集团有限公司	境内非国有法人	1.02%	2,480,000.00	0.00	不适用	0.00			
涂燕娜	境内自然人	0.82%	1,983,300.00	0.00	不适用	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中麦旺球与麦容章系一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。								

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

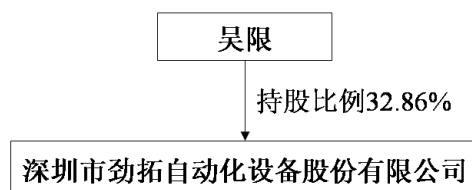
单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
王希坪	新增	0	0.00%	2,804,179	1.16%
玲珑集团有限公司	新增	0	0.00%	2,480,000	1.02%
涂燕娜	新增	0	0.00%	1,983,300	0.82%
中国工商银行股份有限公司—博时信用债券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
邱子聪	退出	0	0.00%	1,315,000	0.54%
深圳市尚桦投资有限公司	退出	0	0.00%	51,567	0.02%

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用**(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表**

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系**5、在年度报告批准报出日存续的债券情况**适用 不适用**三、重要事项****1、公司控股股东筹划委托公司部分表决权暨公司控制权变更事项的情况**

公司 2023 年 1 月 20 日收到控股股东吴限先生出具的《关于筹划委托表决权暨上市公司控制权变更事项的告知函》《表决权委托意向协议》，其拟筹划向东阳经鸿伟畅企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“东阳经鸿伟畅”）委托公司 27.9%表决权，该事项可能涉及公司控制权变更。同时结合双方后续签署的补充协议，该《表决权委托意向协议》有效期至 2024 年 5 月 30 日止。具体情况详见公司在 2023 年 1 月 30 日、2023 年 2 月 8 日、2023 年 3 月 20 日、2023 年 5 月 30 日、2023 年 12 月 30 日披露于巨潮资讯网的公告。

东阳经鸿伟畅于 2023 年 3 月至 4 月买入公司股份，于 2023 年 11 月出售所持公司部分股份；截至 2023 年 12 月 31 日持有公司 609,400 股股份，占公司总股本的 0.25%。

根据东阳经鸿伟畅书面说明：“东阳经鸿伟畅买入公司股份系基于对公司发展前景和投资价值的认可，与《表决权委托意向协议》项下表决权委托事项无关。东阳经鸿伟畅买入公司股份，不构成表决权委托事项的前提条件，不会对表决权委托事项是否签署正式协议并实施造成影响。表决权委托事项是否签署正式协议并实施、实施计划等，亦不构成东阳经鸿伟畅买入公司股份的前提条件。”

东阳经鸿伟畅卖出公司股份，系根据自身发展规划卖出股票。东阳经鸿伟畅卖出公司股份不涉及内幕交易。

东阳经鸿伟畅卖出公司股份，与拟收购公司的意向无关，不会对表决权委托事项的具体方案、是否最终实施造成影响。

截至本报告日，经过前期磋商过程，东阳经鸿伟畅与吴限正就《表决权委托意向协议》项下表决权委托事项是否最终实施进行协商，是否签署正式协议并实施、是否终止《表决权委托意向协议》等尚未确定。

东阳经鸿伟畅不存在与吴限或公司其他股东签署《一致行动协议》的情形，不存在与吴限或公司其他股东形成其他一致行动安排的情形。”

2、公司控股股东收到行政处罚决定书及市场禁入决定书的情况

2023 年 12 月 15 日，公司控股股东吴限先生收到中国证监会的《行政处罚决定书》和《市场禁入决定书》，中国证监会对吴限先生没收违法所得及罚款合计 264,420,136.94 元和采取 5 年市场禁入措施。具体情况详见公司 2023 年 12 月 18 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日